

تحضير أغشية (CCTS) الرقيقة ودراسة Cu<sub>2</sub>CoSnS<sub>4</sub> (CCTS) الرقيقة ودراسة خصائصها التركيبية والبصرية والكهربائية

رسالة مقدمة الى مجلس كلية العلوم – جامعة ديالى وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الفيزياء

من قبل



بكالوريوس علوم فيزياء 2015 م

بإشراف أ.د. نبيل علي بكر أ. أسعد أحمد كامل

2019 م

**-**\$ 1440



# الى بؤرة النور التي عبرت بي نحو الامل والاماني الجميلة واتسع قلبه ليحتوي حلمي حين ضاقت الدنيا فروض الصعاب من اجلي وسار في حلكة الدرب ليغرس معاني النور والصفاء في قلبي.... أبي الغالي نبض الحياة ونعمة ربي .....أمي ذخري وعوني وسندي .....إخوتي (انيس،ياسر،سيف،حسام،اسيل،سارة،مروة،غفران،مودة) كل صديق أراد لي النجاح.... و دعا لي سارية العلم والغلى.....أساتذتي

الإهداء

الباحثة



الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه اجمعين ومن سار على دربه واهتدى بهداه الى يوم الدين... أما بعد، في بداية هذا العمل المتواضع الذي اسأل الله له القبول، لا يسعني إلا ان أتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى استاذي الفاضل أ.د. نبيل على بكر واستاذي الفاضل أ. أسعد احمد كامل لتفضلهما بالإشراف على هذه الدراسة، واللذين لم يألوا جهدا في التوجيه والمساعدة بكل ما هو مفيد، ولكل ما ابدوه من ملاحظات وارشادات قيمة كان لها اكبر الأثر في انجاز هذا البحث وإخراجه على اكمل وجه، جزاهما الله عنى خير الجزاء، كما اتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى عمادة كلية العلوم- قسم الفيزياء لمنحهم الفرصة لى لإكمال دراستي، كما اتقدم بجزيل الشكر والامتنان الي أ.د. صباح انور سلمان و أ. م. د. زياد طارق خضير و م. د. عمار عايش حبيب ولجميع اساتذتي الكرام في قسم الفيزياء لمدهم يد العون لي ومساعدتي طيلة فترة البحث داعية الله المولى عز وجل لهم بدوام الصحة والعافية وأن يحفظهم خدمة للعلم. واتقدم بجزيل شكري وامتنانى الى جميع منتسبى مكتبة كلية العلوم وان انسى فلا انسى زملائي في مختبر الدراسات ومقاعد الدراسة. مع خالص شكري واعتزازي وتسامحي الي كل من وضع العثرات في طريقي ليجعلني اصلب عوداً وأكثر قوة وايمانا في هذه الحياة. ولا يسعني إلا أن أسجل كلمات الشكر و الامتنان إلى الذين لم يبخلوا عليّ بالعون و المساندة و النصيحة. و كل من فاتنى ذكرهم و ساهموا بجهد أو كلمة طيبة لدعم هذا العمل. وفي الختام اللهم اني أسألك السداد والفلاح، وأن يكون عملي هذا خالصا لوجهك الكريم.

#### الخلاصة

تم في هذا البحث ترسيب اغشية المركب الرباعي Cu<sub>2</sub>CoSnS<sub>4</sub> الرقيقة على قواعد زجاجية (SLG) بدرجة حرارة C 400، بطريقة التحلل الكيميائي الحراري (CSP) وسمك تقريبي (mm) 10±35) وبتأثير تغير نسب تركيز الثايوريا في المحلول، وكانت نسبة الايونات السالبة (Cations) الى الايونات الموجبة (Anions) تساوي (1:5).

وقد تمت دراسة الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية من خلال استخدام تقنيات فحص حديثة وذات مواصفات عالية كحيود الاشعة السينية (GIXRD) و المجهر الالكتروني الماسح الباعث للمجال (FE-SEM)، تأثير هول، مطياف رامان وكذلك مطياف الاشعة فوق البنفسجية- المرئية- تحت الحمراء القريبة بالمدى (nm 1100-300).

حيث اظهرت انماط حيود الاشعة السينية (XRD) بأن جميع الاغشية المرسبة التي تم ترسيبها تعود للمركب الرباعي CCTS النقي بتركيب متعدد التبلور وطور (Stannite) الرباعي القائم وبالاتجاه السائد(204) فكلما كان تجانس المواد في المحلول افضل زاد تبلور الاغشية. وباعتماد طريقة (Scherrer Formula) تم حساب معدل الحجم البلوري للأغشية اذ بلغت اقصى قيمة له (10.61 nm) للغشاء CCTS4. ثم اكد تحليل طيف رامان نقاوة طور تشكل اغشية المركب بظهور القمة الاساس للمركب CCTS5 في المدى (<sup>1–</sup>225) ترافقها القمم الثانوية المعززة لها. و دلت نتائج (FE–SEM) على تكون تراكيب نانوية وبأشكال متعددة السطوح (Cauliflower) شبيهة بالقرنبيط (24.86 nm) مع وجود نمو ثانوي، اذ

وقد تمت دراسة الخصائص البصرية للأغشية كافة من خلال تسجيل طيفي النفاذية والامتصاصية ولمدى الاطوال الموجية (nm 100 moc)، اذ اظهرت النتائج ان الامتصاص يحدث في المنطقة المرئية وفوق البنفسجية. من خلال معادلة (Tauc) تم حساب فجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح فكانت قيمها تتراوح بين (və 1.85–1.3) لذا تعتبر هذه الاغشية مناسبة للاستخدام في تطبيقات الخلايا الشمسية، وحسبت الثوابت البصرية (معامل الامتصاص، ثابت العزل البصري بجزأيه الحقيقي والخيالي) كدالة لطاقة الفوتون ومعامل الانكسار ومعامل الخمود كدالة للطول الموجي اذ كانت قيم معامل الامتصاص بحدود (10<sup>2</sup> cm<sup>-1</sup>).

بين قياس تأثير هول ان اعلى قيمة للتوصيلية كانت  $(\Omega.cm)^{-1}$  للغشاء CCTS4 تقابلها اعلى تحركية بقيمة ( $1.822 \text{ cm}^2/\text{V.s}$ ).

# قائمة المحتويات

رقم الصفحة	العنوان	الفقرة
Ι	قائمة المحتويات	
VI	قائمة الاشكال	
X	قائمة الجداول	
XI	قائمة الرموز	
XIV	قائمة الاختصارات	
1-20	مقدمة عامة (General Introduction)	الفصل الاول
1	المقدمة (Introduction)	(1-1)
2	طرائق تحضير الاغشية الرقيقة (Thin Films Preparation Methods)	(2-1)
4	طريقة التحلل الكيميائي الحراري (Chemical spray Pyrolysis method(CSP))	(3-1)
5	آلية تكوين الاغشية الرقيقة (Mechanism of Thin Films Formation)	(4-1)
7	تأثير حجم القطرة (The Drop Size Effect)	(5-1)
9	تركيب أغشية (Cu <sub>2</sub> CoSnS <sub>4</sub> ) الرقيقة (Crystal Structure of (CCTS) Thin Films)	(6-1)
10	تطبيقات اغشية (CCTS) الرقيقة (Applications of (CCTS) Thin films)	(7-1)
10	الدراسات السابقة (Literature Review)	(8-1)
20	الهدف من البحث (Aim of The work)	(9-1)
21-56	الجزء النظري (Theoretical Part)	الفصل الثاني
21	المقدمة (Introduction)	(1-2)
21	اشباه الموصلات (Semiconductors)	(2-2)

22	التركيب البلوري لأشباه الموصلات	(3-2)
	(Crystal structure of Semiconductors)	
22	اشباه الموصلات البلورية	(1-3-2)
	(Single Crystal Semiconductors)	
24	اشباه الموصلات العشوائية	(2-3-2)
	(Amorphous Semiconductors)	
25	مرکبات (Cu <sub>2</sub> -II-IV-VI <sub>4</sub> )	(4-2)
	(Cu <sub>2</sub> -II-IV-VI <sub>4</sub> Compounds)	
28	نظريه حزم الطاقه في المواد الصلبه	(5-2)
	(Energy Band Theory in Solid Materials)	
31	الخصائص التركيبية	(6-2)
	(Structural Properties)	
31	حيود الاشعة السينية	(1-6-2)
	(X-Ray diffraction)	
33	قانون براك للحيود	(2-6-2)
	(The Bragg law of diffraction)	
34	المعلمات التركيبية	(7-2)
	(Structural Parameters)	
37	مطياف رامان	(8-2)
	(Raman Spectroscopy)	
41	تفاعل الضوء مع شبه الموصل	(9-2)
	(Interaction Of Light with Semiconductor)	
42	الخصائص البصرية	(10-2)
	(Optical Properties)	
54	الخصائص الكهربائية	(11-2)
	(Electrical Properties)	
57-74	الجزء العملي	الفصل الثالث
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
57	المقدمه	(1-3)
	(Introduction)	
58	منظومه التحلل الكيميائي الحراري	(2-3)
	(Chemical Spray Pyrolysis System)	(0.0)
63	تحضير الاغشيه الرفيقه	(3-3)
	(Preparation of Thin Films)	
63	تنظيف قواعد الترسيب	(1-3-3)
	(Cleaning Substrate Deposition)	
64	تحضير المحلول	(2-3-3)
	(Preparation of Solution)	
66	ترسيب الاغشية	(3-3-3)
	(Deposition of Films)	

68	قياس سمك الأغشية	(4-3)
	(Measurement of Films Thickness)	
69	التقنيات المستخدمة في دراسة الخصائص التركيبية لأغشية	(5-3)
	(CCTS)	, , ,
	(Technique Used to Study the Structure	
	Properties of (CCTS) Thin Films)	
69	تقنية حيود الأشعة السينية	(1-5-3)
	(X-Ray diffraction Technique)	
71	المجهر الالكتروني الماسح الباعث للمجال	(2-5-3)
	(Field Emission Scanning Electron Microscopy	
	(FE-SEM) Measurements)	
73	مطيافية رامان	(3-5-3)
	(Raman Spectroscopy Measurements)	
73	القياسات البصرية	(6-3)
	(Optical Measurements)	
74	القياسات الكهربائية	(7-3)
	(Electrical Measurements)	
75-105	النتائج والمناقشة	الفصل الرابع
	(Results and Discussion)	
	()	
75	المقدمة	(1-4)
75	المقدمة (Introduction)	(1-4)
75 75	المقدمة (Introduction) نتائج الفحوصات التركيبية	(1-4) (2-4)
75 75	المقدمة (Introduction) نتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements)	(1-4) (2-4)
75 75 75	المقدمة (Introduction) نتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) نتائج فحوصات حيود الاشعة السينية	(1-4) (2-4) (1-2-4)
75 75 75	المقدمة (Introduction) نتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) نتائج فحوصات حيود الاشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests)	(1-4) (2-4) (1-2-4)
75 75 75 79	المقدمة (Introduction) نتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) نتائج فحوصات حيود الاشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests) ثوابت الشبيكة (a, c) ونسبة متجه الشبيكة (c/a)	(1-4) (2-4) (1-2-4) (1-1-2-4)
75 75 75 79	المقدمة (Introduction) نتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) نتائج فحوصات حيود الاشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (a, c) (Lattice Constant (a, c) and lattice Vector (c/a))	(1-4) (2-4) (1-2-4) (1-1-2-4)
75 75 75 79 79	المقدمة (Introduction) نتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) نتائج فحوصات حيود الاشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (a, c) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a) عامل التشكيل	(1-4) (2-4) (1-2-4) (1-1-2-4) (1-2-2-4)
75 75 75 79 79	المقدمة (Introduction) نتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) نتائج فحوصات حيود الاشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (a, c) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a) عامل التشكيل (Lattice Constant (a, c) and lattice Vector (c/a)) عامل التشكيل	(1-4) (2-4) (1-2-4) (1-1-2-4) (1-2-2-4)
75 75 75 79 79 79 79	المقدمة المقدمة (Introduction) iتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) iتائج فحوصات حيود الاشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (a, c) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a) iter (c/a) alab littice Constant (a, c) and lattice Vector (c/a) alab litticy (Texture Coefficient (T <sub>c</sub> ))	(1-4) $(2-4)$ $(1-2-4)$ $(1-2-2-4)$ $(1-3-2-4)$
75 75 75 79 79 79 79	المقدمة المقدمة (Introduction) iتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) iتائج فحوصات حيود الاشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a)) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a) (c/a) عامل التشكيل (c/a) عامل التشكيل (c/a) معدل الحجم البلوري (c/a) معدل الحجم البلوري (Average Crystalline size (D <sub>ave</sub> ))	(1-4) $(2-4)$ $(1-2-4)$ $(1-2-2-4)$ $(1-3-2-4)$
75 75 75 79 79 79 79 82	المقدمة المقدمة (Introduction) iتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) iتائج فحوصات حيود الاشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (a, c) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a) ونسبة متجه الشبيك (c/a) ونسبة (c/a) ونسة (c/a) ونسبة (c/a) ونسبة (c/a) ونسبة (c/a) ونسبة (c/a) ونسة (c/a) ونسبة (c/a) ونسبة (c/a) ونسبة (c/a) ونسة (c/a) ونسة (c/a) ونسبة (c/a) ونسة (c/a) ونسبة (c/a) والم (c/a) والم (c/a) (c/	(1-4) $(2-4)$ $(1-2-4)$ $(1-2-2-4)$ $(1-3-2-4)$ $(2-2-4)$
75 75 75 79 79 79 82	المقدمة المقدمة (Introduction) iتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) iتائج فحوصات حيود الاشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests) (c/a) فرابت الشبيكة (a, c) (c/a) identice Constant (a, c) and lattice Vector (c/a) (Lattice Constant (a, c) and lattice Vector (c/a)) عامل التشكيل (Texture Coefficient (T <sub>c</sub> )) معدل الحجم البلوري (Average Crystalline size (D <sub>ave</sub> )) iتائج تحليل طيف رامان (Results of Raman Spectroscopy Measurements)	(1-4) $(2-4)$ $(1-2-4)$ $(1-1-2-4)$ $(1-2-2-4)$ $(1-3-2-4)$ $(2-2-4)$
75 75 75 79 79 79 79 82 82 85	(Introduction) نتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) نتائج فحوصات حيود الاشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests) ثوابت الشبيكة (a, c) a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a) ثوابت الشبيكة (a, c) (c/a) (Lattice Constant (a, c) and lattice Vector (c/a)) عامل التشكيل (Texture Coefficient (T <sub>c</sub> )) معدل الحجم البلوري (Average Crystalline size (D <sub>ave</sub> )) iتائج تحليل طيف رامان (Results of Raman Spectroscopy Measurements) iتائج فحوصات المجهر الالكتروني الماسح الباعث للمجال	(1-4) $(2-4)$ $(1-2-4)$ $(1-1-2-4)$ $(1-2-2-4)$ $(1-3-2-4)$ $(2-2-4)$ $(3-2-4)$
75 75 75 79 79 79 79 82 82 85	(Introduction) (Introduction) itility الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) itility فحوصات حيود الاشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a) ونسبة متجه التبيكة (c/a) ونسبة متجه التبيكة (c/a) ونسبة متجه الته ونسبة متجه الماليكة (c/a) والي الماليكة (c/a) والمالي	(1-4) $(2-4)$ $(1-2-4)$ $(1-1-2-4)$ $(1-3-2-4)$ $(2-2-4)$ $(3-2-4)$
75 75 75 79 79 79 79 82 85	(Introduction) itility الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) itility فحوصات حيود الإشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests) itel (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a)) itel (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a)) (Lattice Constant (a, c) and lattice Vector (c/a)) alob litricy (Texture Coefficient (T <sub>c</sub> )) (Average Crystalline size (D <sub>ave</sub> )) itel (Results of Raman Spectroscopy Measurements) itel خوصات المجهر الإلكتروني الماسح الباعث للمجال (Results of Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM)Tests)	(1-4) $(2-4)$ $(1-2-4)$ $(1-1-2-4)$ $(1-2-2-4)$ $(1-3-2-4)$ $(2-2-4)$ $(3-2-4)$
75 75 75 79 79 79 79 82 82 85 85	(Introduction) نتائج الفحوصات التركيبية (Results of Structural Measurements) نتائج فحوصات حيود الاشعة السينية (Results of X-Ray diffraction(XRD)Tests) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (a, c) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a) (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (c/a) ونسبة متجه الشبيكة (Results of Raman Spectroscopy Measurements) (Results of Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM)Tests) iتانج القياسات البصرية	(1-4) $(2-4)$ $(1-2-4)$ $(1-1-2-4)$ $(1-2-2-4)$ $(2-2-4)$ $(2-2-4)$ $(3-2-4)$ $(3-4)$

90	الامتصاصية	(1-3-4)
	(Transmission and Absorption)	
91	معامل الامتصاص	(2-3-4)
	(Absorption Coefficient (α))	
92	حسابات فجوة الطاقة	(3-3-4)
	(Calculation of energy gap(E <sub>g</sub> ))	
94	معامل الانكسار	(4-3-4)
	(Refractive index (n <sub>•</sub> ))	
95	معامل الخمود	(5-3-4)
	(Extinction Coefficient ( k <sub>o</sub> ))	
96	ثابت العزل البصري	(6-3-4)
	(Optical Dielectric Constant)	
97	نتائج الفحوصات الكهربائية	(4-4)
	(Electrical Measurements)	
100	الاستنتاجات	(5-4)
	(Conclusions)	
101	المشاريع المستقبلية	(6-4)
	(Future works)	
	المصادر	
	(References)	

## قائمة الاشكال

الصفحة	عنوان الشكل	الرقم
1-20	مقدمة عامة	الفصل الاول
3	مخطط للطرائق الشائعة في ترسيب الاغشية الرقيقة	(1-1)
6	مراحل تكوين الاغشية الرقيقة	(2-1)
8	تأثر طبيعة الاغشية الرقيقة المترسبة بحجم القطرة و درجة حرارة القاعدة	(3-1)
9	البناء البلوري لمركب (CCTS)	(4-1)
21-56	الجزء النظري	الفصل الثاني
24	ترتيب الذرات في المواد الصلبة	(1-2)
26	بعض انواع مركبات كبريتيد النحاس	(2-2)
27	اشتقاق المركبات الثلاثية والرباعية من مشبك الزنك	(3-2)
28	كثافة الحالات في مركبات كبريتيد النحاس الرباعية	(4-2)
29	حزم الطاقة في المواد الصلبة	(5-2)
30	انشطار حزم الطاقة	(6-2)
32	حيود الاشعة السينية (XRD) في الاغشية الرقيقة a:عشوائية b:احادية التبلور c:a	(7-2)
34	الحيود في المستويات البلورية	(8-2)
40	استطارة رامان واستطارة رايلي	(9-2)
40	مخطط لأجزاء تقنية تحليل طيف رامان	(10-2)
45	حافة الامتصاص البلورية في شبه الموصل البلوري	(11-2)

48	الانتقالات الالكترونية المباشرة وغير المباشرة	(12-2)
56	التكوين الاساسي لظاهرة هول	(12-2)
57-74	الجزء العملي	الفصل الثالث
57	خطوات تحضير ودراسة الاغشية المحضرة	(1-3)
58	منظومة الرش الكيميائي الحراري المستعملة في تحضير الاغشية	(2-3)
60	رسم تخطيطي لجهاز الرش	(3-3)
62	مقياس تدفق الهواء	(4-3)
70	التشخيص بالأشعة السينية	(5-3)
72	الرسم التخطيطي لجهاز FE-SEM	(6-3)
74	(a) صورة لجهاز قياس تأثير هول (b) قاعدة النماذج	(7-3)
75-101	النتائج والمناقشة	الفصل الرابع
76	انماط حيود الاشعة السينية لأغشية CCTS الرقيقة بتأثير تغير تركيز الثايوريا في المحلول	(1-4)
77	بطاقة (ICDD) لمركب (CCTS) المرقمة (26-0513)	(2-4)
81	معدل حجم البلوريات للأغشية (CCTS(1,2,3,4,5,6,7)	(3-4)
84	قمم طيف رامان الناتجة للغشاءين CCTS(1,2,3,4,5,6,7)	(4-4)
86	صور FE-SEM لأغشية (1,2,3)	(5a-4)
87	صور FE-SEM لأغشية (4,5,6)	(5b-4)
88	صور FE-SEM للعينات (7)CCTS مع صورة للمقطع العرضي للعينتين (CCTS4,7)	(5c-4)
89	تغير معدل الحجم الحبيبي مع نسب تركيز الثايورياً في المحلول	(6-4)
90	امتصاصية أغشية المركب CCTS	(7-4)
91	معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون لأغشية CCTS	(8-4)
93	<sup>2</sup> ((αhv)) كدالة لطاقة الفوتون للأغشية CCTS(1,2,3,4,5,6,7)	(9-4)

94	معامل الانكسار لأغشية CCTS	(10-4)
95	معامل الخمود لأغشية CCTS	(11-4)
96	الجزء الحقيقي لثابت العزل لأغشية CCTS	(12a-4)
97	الجزء الخيالي لثابت العزل لأغشية CCTS	(12b-4)
99	العلاقة بين نسب تركيز الثايوريا كل من التوصيلية والمقاومية في اغشية CCTS	(14a-4)
99	علاقة كل من تركيز حاملات الشحنة وتحركيتها مع نسب تركيز الثايوريا	(14b-4)

# قائمة الجداول

الصفحة	عنوان الجدول	الرقم
64	بعض من خصائص المواد الأولية المستخدمة في تحضير الاغشية	(1-3)
79	مواقع القمم والمسافة البينية للمستويات البلورية وعرض منتصف القمة والحجم البلوري ومعدل الحجم البلوريات لكافة اغشية CCTS المحضرة	(1-4)
81	قيم كثافة الانخلاعات وعدد البلوريات وعامل التشكيل والمطاوعة المايكروية لنماذج اغشية CCTSالرقيقة	(2-4)
81	قيم ثوابت الشبيكة ونسبة متجه الشبيكة وحجم خلية الوحدة المحسوبة لأغشية CCTS الرقيقة	(3-4)
84	نتائج تحليل طيف رامان	(4-4)
86	معدل الحجم الحبيبي المحسوب من خلال صور -FE SEM	(5-4)
93	قيم فجوة الطاقة	(6-4)
99	نتائج قياس تأثير هول	(7-4)

# قائمة الرموز

وحدة القياس	المعنى	الرمز
cm <sup>-1</sup>	معامل الامتصاص	α
m/s	سرعة الضوء في الفراغ	c
cm/v.s	تحركية هول	$\mu_{ m H}$
cm <sup>3</sup> /C	معامل هول	R <sub>H</sub>
cm <sup>-3</sup>	تركيز حاملات الشحنة	n <sub>H</sub>
eV	طاقة الفونون	Ε <sub>ph</sub>
eV	فجوة الطاقة البصرية	${ m E_g}^{ m opt}$
J/K	ثابت بولتزمان	k <sub>B</sub>
J.s	ثابت بلانك	h
Mol/L	التركيز المولاري	М
g/mol	الوزن الجزيئي	$\mathbf{M}_{wt}$
eV	فجوة الطاقة	$\mathbf{E}_{\mathbf{g}}$
Å	المسافة بين المستويات البلورية	d <sub>hkl</sub>
nm	الطول الموجي	λ
deg	زاوية سقوط الأشعة السينية	θ
$(\Omega.cm)^{-1}$	التوصيلية الكهربائية	σ
С	شحنة الإلكترون	e
s <sup>-1</sup>	التردد الزاوي	W
C/V.m <sup>2</sup>	سماحية الفراغ	εο
eV/m <sup>2</sup> .s	الشدة النافذة	I <sub>x</sub>
eV/m <sup>2</sup> .s	الشدة الساقطة	Io
Å	ثوابت الشبيكة	a,c

V	فولتية هول	$V_{\rm H}$
W/m <sup>2</sup>	شدة المجال المغناطيسي	Bz
A.cm <sup>-2</sup>	كثافة التيار	J
g	كتلة مادة الغشاء	m
nm	سمك الغشاء	t
cm <sup>2</sup>	مساحة الغشاء	S
g/cm <sup>3</sup>	كثافة مادة الغشاء	ρ
eV	طاقة الفونون	Eph
cm <sup>2</sup> /v.s	تحركية الإلكترونات	μn
cm <sup>2</sup> /v.s	تحركية الفجوات	$\mu_{ m p}$
-	عدد الإلكترونات لوحدة الحجم	n
-	عدد الفجوات لوحدة الحجم	р
-	النفاذية	Т
-	الانعكاسية	R
-	الامتصاصية	Α
-	معامل الانكسار المعقد	Ν
-	الجزء الحقيقي من معامل الانكسار	n <sub>o</sub>
-	معامل الخمود	K.
-	ثابت العزل الكهربائي	3
-	الجزء الحقيقي لثابت العزل	ε <sub>1</sub>
-	الجزء الخيالي لثابت العزل	ε <sub>2</sub>

قائمة المختصرات

المعنى	الاختصار
<b>Copper Cobalt Tin Sulfied</b>	CCTS
Full Width at Half Maximum	FWHM
Chemical Spray Pyrolysis	CSP
X-ray diffraction	XRD
<b>Grazing Incidence X-Ray Diffraction</b>	GIXRD
International Center for Diffraction Data	ICDD
Ultra Violet	UV
Soda Lime Glass	SLG
Field Emission Scanning Electron Microscopy	FE-SEM

الفصل الأول مقدمة عامة

### **Chapter One**

General Introduction

#### (1-1) المقدمة

### (Introduction)

إنَ مصطلح الاغشية الرقيقة يطلق لوصف طبقة او عدة طبقات (Layers) من ذرات المادة لا يتعدى سمكها المايكرومتر الواحد او عدة اجزاء من النانومتر إذ أن الاغشية المحضرة رقيقة وهشة جدا (سهلة الكسر) لذا ترسب على قواعد صلبة و بطرائق مختلفة[1]. من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة الدائمة والنظيفة من خلايا شمسية توجهت جهود الباحثين نحو تحضير مواد جديدة تمكن من انتاج الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء[2]. محاولة منهم للاستعاضة عن السليكون المتبلور بسبب محدوديته وغلائه بمواد شبه موصلة اكثر انتشارا وإقل كلفة من خلال تحضير طبقات ماصة (طبقة فعالة) باستخدام تقانة الاغشية الرقيقة[3]. ومع ذلك يتم انتاج اكثر من 80% من الطاقة في العالم عن طريق الوقود الاحفوري غير المتجدد (الفحم، النفط، والغاز الطبيعي) حيث ادى الاستخدام المفرط لهذا النوع من الوقود الى تلوث البيئة[4]. و أن كل عمليات اتلاف الخلايا الشمسية ذات الاغشية الرقيقة هي مصدر قلق كبير. لذلك بذلت جهود كبيرة منذ بداية عام 1950 للقيام بتصميم أشباه موصلات كالكوجينايد الرباعية، هذه المركبات اصبحت موضوع الاهتمام البحثي المكثف للباحثين ذلك لأنها تتكون من عناصر متوفرة وغير سامة و تمتلك فجوة طاقة مثالية لكثير من التطبيقات الضوئية[5]. إذ ان التقدم الاخير للمواد الماصة او الطبقات الفعالة اقتصر على المركبات الثنائية والثلاثية والرباعية مثل وقد كرس اغلب الباحثين عملهم في (SnS,FeS,Cu<sub>3</sub>BiS<sub>3</sub>,Cu<sub>2</sub>SnS<sub>3</sub>Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>) دراسة وتحضير اغشية Cu2CoSnS<sub>4</sub> احد مركبات عائلة شبه الموصلCu-II<sub>2</sub>-III-VI<sub>4</sub> احد بتراكيب نانوية [6].

1

و لا يزال تحضير اغشية CCTS تحديا لأن CCTS مركب رباعي مخطط الطور له معقد جدا وعادة ما يكون من الصعب السيطرة على عملية التنوي والنمو اثناء التحضير مع ذلك فقد حضرت اغشية CCTS في الآونة الاخيرة بنجاح بطرائق مختلفة بهدف استخدامها التطبيقات الفولتاضوئية منها (solvothermal) و (sol-gel) و (hot injection) و (electrospinning)، الفولتاضوئية منها (high temperature route) و (hot injection) و (columnation) و (action تقدم عن الممية اغشية CCTS في الكثير من التطبيقات وفي العديد من المجالات فقد ارتأينا الى دراسة تأثير تركيز عنصر الكبريت في اغشية المركب CCTS الرقيقة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري.

(1-2) طرائق تحضير الاغشية الرقيقة

#### (Thin Films Preparation Methods)

خلال العقود العديدة الماضية، حظيت طرائق الترسيب باهتمام كبير، وعلى مر السنين اكتشفت وطور العلماء طرائق عديدة لتحضير الاغشية الرقيقة وبذلك تعددت طرائق تحضيرها واصبح لكل طريقة مميزاتها لتؤدي الغرض الذي ابتكرت من اجله، وإن اختيار الطريقة المناسبة لتحضير الغشاء يعتمد على خواص عدة منها طبيعة التطبيق ونوعه وكلفة التحضير وسهولته وسرعته بالإضافة الى نوع المواد المستخدمة في التحضير . ويمكن تقسيم طرائق تحضير الاغشية الرقيقة الى نوعين رئيسين [7]. الموضحة فى الشكل (1-1) [8].

- الطرائق الفيزيائية (Physical Methods).
- الطرائق الكيميائية (Chemical Methods).



الشكل (1-1): مخطط للطرائق الشائعة في ترسيب الاغشية الرقيقة [8].

(1–3) التحلل الكيميائي الحراري

### (Chemical Spray Pyrolysis method(CSP))

تم في هذا البحث اعتماد تقنية التحلل الكيميائي الحراري، اذ تحضر الاغشية بهذه الطريقة عن طريق رش محلول المادة المراد ترسيب الغشاء الرقيق منها على قواعد ساخنة بدرجة حرارة ملائمة بحيث تكون اقل من درجة حرارة تطاير المادة. اذ يتكون الغشاء بعد التفاعل الذي يحدث بين ذرات المادة والقاعدة الساخنة ومن الممكن تحديد سمك الغشاء من خلال التحكم بمعدل الترسيب[9].

محاسن طريقة التحلل الكيميائي الحراري:

- تعدُ طريقة اقتصادية نظرا لبساطة وقلة تكلفة الاجهزة المستخدمة لترسيب الاغشية.
  - يمكن تحضير الاغشية فيها بمواصفات جيدة (تجانس عالى وبمساحات كبيرة ).
- تعد طريقة ملائمة لترسيب اغشية لمركبات يتعذر تحضيرها بطرائق اخرى مثل اكاسيد وكبريتات المواد.
  - تمتاز الاغشية الرقيقة المحضرة بهذه الطريقة بالتصاقها القوي بالقاعدة.
- يمكن تحضير الأغشية من مزج مادتين أو أكثر وكذلك يمكن تغيير النسب الداخلة في الغشاء.

ومن مساوئ طريقة الرش الكيميائي الحراري:

- تستعمل مع المواد القابلة للذوبان فقط.
- احتمالية عدم تكون المادة المراد ترسيبها بسبب اختلاف في التفاعل الكيميائي وتكون مادة مختلفة.

(1–4) آلية تكوين الاغشية الرقيقة

#### (Mechanism of Thin Films Formation)

تتصف البنية التركيبية للأغشية الرقيقة بدرجة كبيرة من التعقيد مقارنةً مع المواد الجاسئة سواء كانت احادية التبلور أو متعددة التبلور، و امتلاكها مناطق عدم انتظام وكثافة وعيوب اكبر بكثير عند موازنتها بالمواد الاخرى وذلك لأنها مواد ذات حجوم حبيبية صغيرة جدا. سلوك خصائص الأغشية الرقيقة (البصرية و الكهربائية والميكانيكية) يتحدد بوساطة التركيب و البنية المجهرية و المركبات الكيميائية و النقاوة والتجانس وهذه العوامل تتأثر بقوة بطرائق تحضير الغشاء[10]. وهناك العديد من العوامل التي تحدد الانتظام في الغشاء والبنية البلورية للأغشية الرقيقة بشكل عام، وبشكل خاص فإن التحلل الكيميائي الحراري يضيف عوامل اخرى لها أثر في البنية التركيبية وبداية نمو الغشاء للأغشية المحضرة مثلا حجم القطرة وكثافة توزيع القطرات على وحدة المساحة وقطر فتحة جهاز الترذيذ. يكون تأثير هذه العوامل مباشراً في تجانس الغشاء وبنيته التركيبية التي بدورها تتعكس على الخصائص البصرية والكهربائية[11]. إن الفكرة الاساسية في عملية التحلل الكيميائي الحراري هي توليد رذاذ من قطرات المحلول ونقلها بسرعة ابتدائية نحو سطح القاعدة الساخنة[12]. تتبعها الخطوات الأساسية لآلية نمو الأغشية الرقيقة والتي تتمثل بالاتى:

- حدوث عملية التحلل الكيميائي الحراري للمحلول.
  - انماء الطبقات المطلوبة للمادة.

تمر عملية إنماء طبقات الاغشية بمراحل اساسية تبدأ بمرحلة التنويه أي تكوين النويات التي تعد الاساس الذي يبنى عليه الغشاء الرقيق والتي تتكون عند انتقال الذرات او الايونات او الجزيئات من المصدر إلى القاعدة وتتميز النويات الملتصقة بالقاعدة بحجمها الصغير، ثم تتمو هذه النويات بالأبعاد الثلاثة وبمحاذاة القاعدة اي ان النمو يكون افقياً اكثر مما هو عموديا بسبب الانتشار السطحي للذرات وهذه صفة مميزة لنمو الاغشية الرقيقة، بعد ذلك تتصل هذه النويات الواحدة بالأخرى وتتكون الجزر وهذا مرهونا ببعض العوامل المؤثرة منها (معدل الترسيب، درجة حرارة القاعدة ووجود مواقع التتويه على سطح القاعدة)، تليها مرحلة تكوين الحدود الحبيبية الناتجة عن التحام الجزر مع بعضها لتكوين بلورة احادية التبلور فيما أذا كانت الاتجاهات البلورية للجزر عن التحام الجزر مع بعضها لتكوين بلورة احادية التبلور فيما أذا كانت الاتجاهات البلورية للجزر عن التحام الجزر مع بعضها لتكوين بلورة احادية التبلور فيما أذا كانت الاتجاهات البلورية للجزر عن التحام الجزر مع بعضها لتكوين موف تستمر بالالتحام مع بعضها وتبدأ بتغيير شكلها تمتد وتستطيل مرتبطة مع بعضها مكونة مناطق ضيقة بالقرب من منطقة التصاق بعضها ببعض، وتمتاز هذه المناطق بكونها غير منتظمة وطويلة وتعرف بالقنوات. وفي اثناء استمرار عملية الترسيب تنتج نوى وجزر داخل هذه القنوات وتندمج بسرعة عند ملامسة جدران القنوات مكونة اشباه جسور وتاركة تجاويف داخل الغشاء، تتلاشى هذه القنوات في النهاية مكونة الغشاء نتيجة استمرار تكوين الجزر الثانوية التي تلامس حافات الفجوات ويتدمج مع العشاء. المرار (1–2)



الشكل (1-2): مراحل تكوين الاغشية الرقيقة [13].

#### (1–5) تأثير حجم القطرة

#### (The Drop Size Effect)

تنطلق القطرات بسرعة ابتدائية نحو سطح القاعدة الساخنة ويكون شكل الرش مخروطي ذلك بالاعتماد على المسافة بين فتحة الرش والقاعدة وحجمها كما وضح [14].

ولحجم القطرة تأثير على طبيعة الغشاء المترسب، اذ ان حجم القطرات المتولدة من المحلول لا يرتبط بخواص السائل يعتمد فقط على كثافة توزيع القطرات على وحدة المساحة في اثناء عملية الترسيب وأنَ خصائص الاغشية فضلا عن تأثرها بحجم القطرات فإنها تتأثر بطبيعة ودرجة حرارة القاعدة [15].

الحالة A: يكون حجم القطرة كبيراً نسبيا فالحرارة الممتصة من الوسط المحيط تكون غير كافية لتبخر المحلول بالكامل عند رشه باتجاه القاعدة وبمجرد وصول القطرات الى القاعدة الساخنة يتبخر المحلول تاركا الراسب صلبا، واثناء التبخر يتبدد جزء من الحرارة فتنخفض درجة حرارة القاعدة عند هذه النقطة، مما قد يؤدي الى اجهادات داخلية وبالتالى يكون الغشاء غير متجانس.

الحالة B: في هذه الحالة تجف القطرات قبل وصولها الى سطح القاعدة الساخنة فيحدث تحلل جزئي للمحلول مسببا تكون رواسب.

الحالة C: تمثل التحلل الامثل للحصول على غشاء رقيق، في هذه المرحلة يتبخر المحلول عند أقرب نقطة للقاعدة وقبل وصول الدقائق يكون الوقت كافياً لارتفاع درجة الحرارة إلى درجة حرارة الوسط إذ تتبخر أو تتسامى(Sublimes)، وبذلك يحدث تفاعل يتضمن ما يأتي:

- انتشار الجزيئات المتفاعلة على السطح.
- التصاق جزيئة واحدة أو عدة جزيئات على السطح.

- انتشار سطحي واعادة اتحاد مع الشبيكة ومن ثم انتشار الجزيئات الناتجة الى حيز البخار.
- الحالة D: حجم القطرة صغير، فيحدث تبخر المحلول بصورة كاملة بعيداً عن القاعدة وتصبح الدقائق بلورات صغيرة تكون راسباً اشبه بالمسحوق يعكر الغشاء ويقلل من نفاذية المادة وذلك لان التفاعل الكيميائي في هذه الحالة يكون اسرع مما عليه في الحالات السابقة. الشكل (1–3) يوضح حالات الترسيب اعتماداً على حجم القطرات المتكونة لها [16].

ان الانتقال الأنموذجي للقطرة نحو القاعدة الساخنة يتم عندما تصل القطرة في اللحظة التي يكون فيها المذيب قد تبخر بالكامل، ويتضح مما سبق أن أنسب الظروف لتكوين غشاء بمواصفات جيدة عند حجم القطرة المبين في الحالة C، وعملياً لا يمكن تأكيد الظروف الدقيقة لهذه العملية، فضلاً عن حدوث انتقال من التفاعل المتجانس إلى التفاعل غير المتجانس لعدم وجود حجم محدد للقطرات اذ لابد من السيطرة على عملية الرش للحصول على حجم القطرات المطلوب [17].



الرقيقة (
$$\mathsf{Cu}_2\mathsf{CoSnS}_4$$
 ) تركيب أغشية ( $\mathsf{Cu}_2\mathsf{CoSnS}_4$ 

### (Structural of (Cu<sub>2</sub>CoSnS4)Thin films)

(Cu- Chalcogenides) لعد مركبات مجموعة مركبات كالكوجينايد النحاس (Cu- Chalcogenides) الرياعية يتكون من (Co) = II  $_{\rm e}({\rm Sn}) = VI$  وهي عناصر متوفرة وغير سامة. من المعلوم انه يمكن تشويب شبيكة (Chalcopyrite) المجموعة الفراغية (Durs) بذرات من المعلوم انه يمكن تشويب شبيكة (Chalcopyrite) وذلك باستبدال ذرتين المجموعتين الثانية والخامسة، هذا و يشتق من المركب الثلاثي (CulnS<sub>2</sub>) وذلك باستبدال ذرتين من الانديوم بذرة من الكوبالت (Co) وذرة من القصدير (Sn) حسب قاعدة الثمان، وهو مادة من الانديوم بذرة من الكوبالت (Co) وذرة من القصدير (Sn) حسب قاعدة الثمان، وهو مادة متعددة التبلور من طور (Stannite) بتركيب رياعي قائم (Ietragonal) بمجموعة مكعبة مغلقة متعددة التبلور من طور (Stannite) بتركيب رياعي قائم (Ietragonal) بمجموعة مكعبة مغلقة منادر (I $\overline{42}$ m) وابعاد شبيكة (A 2008) بتركيب رياعي قائم (Ietragonal) بمجموعة مكعبة مغلقة متعددة التبلور من طور (Stannite) بتركيب رياعي قائم (Ietragonal) بمجموعة مكعبة مغلقة منادر (I $\overline{42}$ m) وابعاد شبيكة (A 2008) بتركيب رياعي قائم (Ietragonal) بمجموعة مكعبة معلقة الرياعي من ثلاث ذرات معدن اذ تحبط بذرة الكبريت ذرة كوبالت واحدة وذرتين مندالا



الشكل (1-4): البناء البلوري لمركب CCTS [18].

#### (1–8) تطبيقات أغشية CCTS

#### (Applications of (CCTS) Thin Films)

يعد المركب CCTS احد مركبات اشباه موصلات Chalcogenides وله تطبيقات عدة منها [3].

- تستخدم اغشية CCTS الرقيقة كطبقة ماصة (Active layer) في الخلايا الشمسية وخلايا اكاسيد الوقود الصلبة والخلايا الشمسية الصبغية، اذ اظهرت كفاءة تحويل للطاقة بقيمة (% 3.23) [19]. ويمكن استخدام المحلول الجزيئي لمركب CCTS السائل كطلاء مباشرة كطبقة امتصاص في الخلايا الشمسية ايضا [20].
- تستخدم في المتحسسات وكقطب كهربائي في المكثفات الكهربائية الثلاثية في الخلايا
   الشمسية الحساسة الصبغية بدلا من الا (Platinum) غالي الثمن لاختزال ثلاثي اليوديد
   في الخلايا الشمسية العضوية.
  - تدخل في صناعة الكواشف البصرية (Photo detector).

#### (10-1) الدراسات السابقة

#### (Literature Review)

درس الباحث (Cui et al.,2012) الطرق العامة لتحضير شبه الموصل الرباعي Cu<sub>2</sub>MSnS<sub>4</sub> (Cu<sub>2</sub>MSnS<sub>4</sub>) وقد أثبت ان تحضير أغشية المركب ira بنجاح وبسهولة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري، و تبين من نتائج حيود الاشعة السينية ان لديه انماط حيود غير موجودة ولم تذكر في دراسات اخرى ولا في البطاقة القياسية التي تثبت انه من طور (Stannite or Kesterite) مثل مشبك الخارصين كذلك المركبات الاربعة تبدي سلوك مغناطيسي عالي عند درجات حرارية منخفضة. وان فجوة الطاقة بالمدى (2.5 eV).

درس الباحث (Benchikri et al., 2012) عملية تحضير جزيئات كالكوجينايد الرباعية
للمركبين (Cu2CoSnS4,Cu2ZnSnS4) من منصهر ثيوسينات البوتاسيوم
(Potassium thiocyanate (KSCN)) عند درجة حرارة مرتفعة (400 °C) اذ تسمح
الحرارة العالية بتكوين جزيئات Chalcogenides رباعية نقية عالية التبلور، وقد بين
الباحث أن السيطرة على حجم البلورات الاولية يتم عن طريق تغيير التجانس الكيميائي للمواد
الاولية للتحضير، وأنه يمكن استخدام هذه الطريقة لتحضير طبقات ماصة في الخلايا
الشمسية منخفضة التكلفة. تظهر اطياف رامان المسجلة لأغشية CCTS اختلاف طفيف
في تردد القمة الرئيسي المحدد عند <sup>1-</sup> 326 cm يصاحبه ظهور قمم ثانوية عند <sup>1-</sup> 286 cm
و 359 ${\sf cm}^{-1}$ والقمة ( ${\sf 305}~{\sf cm}^{-1}$ ) بعرض منتصف قمة كبير غير المبرر
لأغشية(Cu <sub>2</sub> ZnSnS <sub>4</sub> ) [22].

حضر الباحث (Cu<sub>2</sub>CoSnS<sub>4</sub>) بلورات نانوية احادية لأغشية (Zhang et al., 2013) بطورين (Qu<sub>2</sub>CoSnS<sub>4</sub>) بزيادة تأثير درجة الحرارة أو عن طريق عملية (Wurtzite and Stannite) بلورين (Wurtzite and Stannite) بزيادة تأثير درجة الحرارة أو عن طريق عملية التلدين بدرجات حرارية عالية، اذ نمت البلورات النانوية (CCTS-Wurtzite) على شكل قضبان نانوية و كانت قيمة فجوة الطاقة لهذه الاغشية (Va 80) ولأغشية (CCTS) على شكل (CCTS-Wurtzite) و كانت قيمة فجوة الطاقة لهذه الاغشية (Va 80) ولأغشية (CCTS) على شكل التلدين بدرجات حرارية عالية، اذ نمت البلورات النانوية (Va 80) ولأغشية (CCTS) على شكل التلدين بدرجات حرارية عالية، اذ نمت البلورات النانوية (Va 80) ولأغشية (CCTS) على شكل البلوري من طور (CCTS) ولأغشية وCCTS) ولأغشية (CCTS) ولأدات قيمة فجوة الطاقة لهذه الاغشية (CCTS) ولأغشية (CCTS) ولأنه بزيادة قضبان نانوية و كانت قيمة فجوة الطاقة لهذه الاغشية (CTS) كانت بقيمة (Va 80) ولأنه بزيادة (CCTS) ولأنه بزيادة تقيمة (CTS) ولأغشية (CTS) ولأغشية (CTS) ولأغشية حران (CTS) والتعام من 2000) ولأذه بزيادة (CTS) ولأو (CTS)) ولأور (CTS) ولأور (CTS)) ولأور (CTS) ولأور (CTS)) ولأور (CTS) ولأور ولأور ولأور القيم المور (CTS) ولأور (CTS) ولأور (CTS) ولأور (CTS) ولأور (CTS))). وظهور القمم الضعيفة حول (CTS) و (CTS) و 30.15° و 30.15° و 30.15° و 30.15° و 20.25° و 30.15° و 20.25° و 20.25° و 20.25° و 20.25° (CTS) ولأور (CTS) و

- عمل الباحث (CCTS) على تحضير محلول مركب (Spin coating) على تحضير محلول مركب (Spin coating)، اذ درس الطور (Sol-gel) وترسيبه على قواعد زجاجية بطريقة (Spin coating)، اذ درس الطور المطلوب تشكله من خلال دراسة تأثير تغير درجة حرارة التلدين على الاغشية المحضرة اذ يتحول الغشاء من التركيب العشوائي الى متعدد التبلور بطور (stannite) بتأثير التلدين، إذ تم معرفة ذلك من خلال اجراء الفحوصات التركيبية لحيود الاشعة السينية وقد وضح الباحث سبب استخدامه طريقة (Sol-gel) لأنه يفضل ان تكون الاغشية الرقيقة ذات معدل خشونة منخفض التكوين وبسطح ناعم [2].
- استطاع الباحث (Shi et al., 2014) تحضير اغشية المركب الرباعي Cosns<sub>4</sub> واستخدم احادية التبلور نانوية التركيب بطريقة الترسيب من المحاليل Solvothermal واستخدم فراعانية التركيب بطريقة الترسيب من المحاليل Solvothermal واستخدم وكشفت احديث النوية الامتصاص للأشعة (112) هو اتجاه النمو السائد وكشفت فحوصات طيف الامتصاص للأشعة UV-Vis ان الاغشية المحضرة ذات معامل امتصاص عالي وفجوة طاقة بقيمة (V-1.5 eV) كما أظهرت هذه الاغشية توصيلية معززة تحت الاشعة المرئية مما يجعلها ملائمة للتطبيقات الضوئية وقد تكون واعدة للاستخدام كطبقات امتصاص للضوء في الخلايا الشمسية كما ان الاسلاك النانوية لأشباه موصلات كطبقات امتصاص للضوء في الخلايا الشمسية كما ان الاسلاك النانوية لأشباه موصلات كطبقات امتصاص للضوء في الخلايا الشمسية كما ان الاسلاك النانوية لأشباه موصلات كطبقات امتصاص للضوء في الخلايا الشمسية كما ان الاسلاك النانوية رامان كما تحريز المان القريبة من القمة <sup>10</sup> 300 cm<sup>-1</sup> معام التوليبة من القمة العرب قمع طيف رامان بأعلى شدة عند <sup>10</sup> 300 cm<sup>-1</sup>.
- رسب الباحث (Gupta et al., 2015) اغشية Cu<sub>2</sub>CoSnS<sub>4</sub> بنجاح (Gupta et al., 2015) بطور Wurtzite بنجاح باستخدام طريقة الحقن الحراري (hot-injection) وقد استخدم عنصر الكبريت كمصدر للكبريت. و درس الباحث الخصائص التركيبية والهيكلية لأغشية CCTS باستخدام فحص

حيود الاشعة السينية (XRD) اذ تظهر انماط حيود الاشعة السينية عند (100) (100, 49.40°,53.32°,58.16°) التي تقابل كل من المستويات (100) (100), (100), (100), (100) لطور Wurtzite على التوالي. وقد أكد أن مادة الغشاء تقع ضمن المواد شبه الموصلة من خلال القياسات البصرية أيضا كانت قيمة مقاومة الاغشية تساوي (0.8 Ω.cm) [25].

- تمكن الباحث (Cu<sub>2</sub>S,SnS<sub>2</sub>,CoS,Cu<sub>3</sub>SnS<sub>4</sub>) من تحضير اغشية CCTS عند درجة حرارة تمكن الباحث (Solvothermal) من خلال دراسة حيود الاشعة السينية فقد للكبريت وعامل مساعد في تكوين 40.0°C من خلال دراسة حيود الاشعة السينية فقد ظهرت انماط الحيود عند (°Cu<sub>2</sub>CoSnS من خلال دراسة حيود الاشعة السينية فقد ظهرت انماط الحيود عند (°Cu<sub>2</sub>CoSnS من خلال دراسة حيود الاشعة السينية فقد المستويات (20.0°C) (004), (201) و (20.0°C), (400), (201) على التوالي بتركيب رياعي قائم بطور (Stannite) ولا وجود لأتماط حيود لأطوار ثانوية تابعة لمركبات ثنائية او ثلاثية او ثلاثية مثل (40.0°C), (202) ويإجراء تحليل طيف رامان للأغشية ظهرت اريعة مع عند (<sup>1-</sup>Cu<sub>2</sub>S,SnS<sub>2</sub>,CoS,Cu<sub>3</sub>SnS<sub>2</sub>) وقد اكد الباحث ان هذه القمم تتفق مع الاهتزاز من الكلي المتماتل لذرات الكبريت في مركبات كالكوجينايد النحاس الرياعية اي ان هذه القمم من الكلي المتماتل ان تعزى لأغشية (200).
- تمكن الباحث (Krishnaiah et al., 2015) من تحضير أغشية CCTS من محاليل المعادن بوساطة عملية الترسيب بالبخار (Thermal decomposition) و محاليل المعادن بوساطة عملية الترسيب والبخار (SLG,FTO) باختلاف تأثير درجة الحرارة والزمن، ودراسة خصائصها التركيبية والبصرية والكهربائية لاستخدامها في التطبيقات

- نجح الباحث (Ozel, 2016) في تحضير أغشية مركبات شبه الموصل الرباعي (Cu<sub>2</sub>FeSnS<sub>4</sub>, Cu<sub>2</sub>CoSnS<sub>4</sub>, Cu<sub>2</sub>NiSnS<sub>4</sub>, Cu<sub>2</sub>MnSnS<sub>4</sub>)
   بتقنية (XRD)، إذ تبين من نتائج فحوصات حيود الاشعة السينية (XRD) و (XRD)
   القياسات البصرية (UV- visible) و (UV- visible) أن الاغشية المحضرة ذات تراكيب نانوية (Nano fiber)
   متصاص عالى مما يجعلها مواد واعدة لتطبيقات الطاقة البديلة [27].
- عمل الباحث (Ghosh et al., 2016) على تحضير اغشية مركبات كبريتيد النحاس (ITO) بطريقة (Cu<sub>2</sub>-II-Sn-S<sub>4</sub>) (II=Fe,Co,Ni) على قواعد من زجاج (ITO) بطريقة (Spin Coating) واتضح ان شكل السطح الخارجي للأغشية عبارة عن بنية مسامية متماثلة بمتوسط سمك للأغشية (1.5mm) كذلك كشف تحليل طيف رامان عن ظهور القمم الرئيسية عند (<sup>1</sup>-331.58cm<sup>-1</sup>) لاCFTS) لاركتاب من الرئيسية عند (<sup>1</sup>-331.58cm<sup>-1</sup>) على تحضير اغشية مركبات كبريتيد النحاس

و (<sup>1</sup>-325cm) لـ(CCTS) و (<sup>1</sup>-330.63cm) لـ(CNTS) نتيجة الحركة الاهتزازية لذرات الكبريت وقد وجد ان قيم فجوة الطاقة هي (1.87eV,1.57eV,1.74eV) للأغشية (CFTS,CCTS,CNTS). جميع نماذج الاغشية الرقيقة المحضرة تتطابق تماما مع بطاقة (250–0575) CZTS ولا وجود لطور ثانوي مثل CuS عند درجة حرارة منخفضة [28].

- استطاع الباحث (Mokurala et al., 2016) تحضير اغشية (CCTS,CFTS) الرقيقة كمواد نشطة كهربائيا من محاليل المواد اذ تمت اضافة النسب (2:1:1:4) من الرقيقة كمواد نشطة كهربائيا من محاليل المواد اذ تمت اضافة النسب (2:1:1:4) من (EG) وتخلط بواسطة (EG) وتخلط بواسطة الخلاط لمدة min 30 المذابة في mokurala حيود الاشعة السينية تتطابق مع البطاقة الخلاط لمدة min 30 ليتجانس المحلول. أنماط حيود الاشعة السينية تتطابق مع البطاقة الخلاط لمدة min 30 ليتجانس المحلول. أنماط حيود الاشعة السينية تتطابق مع البطاقة الغاسية ذات الرقم (Stannite وكان معادلة (Scherrer) بطور Stannite وكان معدل الحجم البلوري المحسوب يساوي (10nm) باستخدام معادلة (Scherrer) ،كما أظهرت نتائج قياس تأثير هول أن الاغشية المحضرة من نوع (P-type)، وكانت قيم كل من التحركية وتركيز الحاملات و المقاومية تساوي (mokurala معادلة (μ=11.5 cm<sup>2</sup>v<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>) و (met 2.2) و (n=5.2×10<sup>16</sup> cm<sup>-1</sup>) و (μ=11.5 cm<sup>2</sup>v<sup>-1</sup>s<sup>-1</sup>) و (2.0) من التحركية (2.0)
- حضر الباحث (Bakr et al., 2016) اغشية (CZTS) المترسبة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري عند درجة حرارة قاعدة (3 400) ذات سمك يتراوح بين (mm-350 mm) حيث درس الباحث تأثير تغير تركيز الثايوريا، اظهرت نتائج فحوصات حيود الاشعة السينية ان الاغشية المحضرة ذات تركيب متعدد التبلور من النوع الرباعي ذو الطور السائد (112) حيث تم حساب الحجم البلوري باستخدام معادلة شرر ووجد ان اغشية CZTS المحضرة عند

تركيز (M 0.2 M) من الثايوريا تمتلك اكبر قيمة للحجم البلوري بقيمة (31.25 nm) و اقل قيمة للحجم البلوري كانت(nm 18.02 nm) عندما كان تركيز الثايوريا (M 0.16 M).

- Cu<sub>2</sub>MSnS4(M=Co<sup>+2</sup>,Ni<sup>+2</sup>) بتصنيع أغشية (Liu et al., 2017) قام الباحث (Liu et al., 2017) الرقيقة بتركيب نانوي واستخدامها في تطبيقات الكواشف البصرية ووضح الباحث انه يمكن الرقيقة بتركيب نانوي واستخدامها في تطبيقات الكواشف البصرية ووضح الباحث انه يمكن اعتبار (CCTS,CNTS) كمركبات  $Cu_2$ ZnSnS<sub>4</sub> اذ يمكن استبدال أيون <sup>2+</sup> rl بأيون Co<sup>+2</sup> أو ايون <sup>2+</sup> Ni باستخدام تقنية الاستبدال الأيوني من خلال عملية فصل التفاعل المؤكسد لأيونات (Ni<sup>+2</sup>,Co<sup>+2</sup>) مع بخار السلينيوم بدرجة حرارة عالية. ظهرت انماط حيود الاشعة السينية ل (CCTS) عند (°,56.7°,48.0°,56.7°) والتي تقابل المستويات (111) و (220) و (111) بالمقارنة مع البطاقة القياسية (CNTS,CCTS على التوالى [15]. الطاقة تساوى (200 ev,1.35 ev) لأغشية CNTS,CCTS على التوالى [15].
- حضر الباحث (Maldar et al., 2017b) اغشية CCTS الرقيقة من كلوريدات المعادن مع الكمية المكافئة لها من الثابوريا، وقد حضر محلول المواد من اذابتها في كحول الميثانول حيث تم ترسيبها على قواعد زجاجية (SLG) بطريقة التحلل الكيميائي الحراري وبدرجة حرارة قاعدة مختلفة (° 275,325,375). درس الباحث الخصائص التركيبية والبصرية للأغشية المحضرة، إذ اظهرت نتائج حيود الاشعة السينية ان الاغشية ذات تركيب متعدد اللأغشية المحضرة، إذ اظهرت نتائج حيود الاشعة السينية ان الاغشية ذات تركيب متعدد حرارة زاد من الطور (Stannite) و بالوجه السائد (112) ذو شكل رباعي قائم، كذلك تم تحديد الطور النقي لأغشية CCTS من تحليل طيف رامان للأغشية المرسبة عند درجة التبلور من الطور (Stannite) و بالوجه السائد (122) ذو شكل رباعي قائم، كذلك تم حرارة (° 2005) بالمدى (<sup>10</sup> 2000) ، إذ ظهرت اعلى شدة عند (<sup>10</sup> 2000) من تحليل طيف رامان للأغشية المرسبة مند درجة محرارة (° 2000) بالمدى (<sup>10</sup> 2000) ، إذ ظهرت اعلى شدة عند (<sup>11</sup> 2000) من تحليل طيف رامان للأغشية المرسبة مند درجة مرارة (° 2000) بالمدى (<sup>10</sup> 2000) ، إذ ظهرت اعلى شدة عند (<sup>11</sup> 2000) من تحليل طيف رامان للأغشية المرسبة مند درجة مرارة (° 2000) بالمدى (<sup>10</sup> 2000) ، إذ ظهرت اعلى شدة عند (<sup>11</sup> 2000) محرارة (° 2000) بالمدى (<sup>10</sup> 2000) ، إذ ظهرت اعلى شدة عند (<sup>11</sup> 2000) من تحليل مين الباحث ان غياب القمة عند (<sup>10</sup> 2000) ، إذ ظهرت اعلى شدة عند (<sup>11</sup> 2000) مرارة (<sup>11</sup> 2000) من تحليل مين الباحث ان غياب القمة عند (<sup>10</sup> 2000) من محليل مين الباحث ان غياب القمة عند (<sup>10</sup> 2000) من محليل مين المرور النوية مثل كما بين الباحث ان غياب القمة عند (<sup>10</sup> 2000) من محليل مين الباحث ان غياب القمة عند (<sup>10</sup> 2000) من مرارة الخوصات البصرية ان قيمة كما بين الباحث ان غياب القمة عند (<sup>10</sup> 2000) من مرازة منائج الفحوصات الموار ثانوية مثل كما بين الباحث الغشية المرورة (<sup>10</sup> 2000) و أوضحت نتائج الفحوصات البصرية القمة مند (<sup>10</sup> 2000) من مرارة الخوصات البصرية الغربة القمة مند (<sup>10</sup> 2000) من مرارة (<sup>10</sup> 2000) من مرارة (<sup>10</sup> 2000) و أوضحت نتائج الفحوصات البصرية الخوسة مثل الغشية المرورة (<sup>10</sup> 2000) من مرارة الخوصات البورة الفروصات الباحة من مرارة (<sup>10</sup> 2000) من مرارة (<sup>10</sup> 2000) من مرارة الخوصات الفروضا الفروضا الفروضا الفوضا مد الفوضا الفوضا الفوضا

فجوة الطاقة تقل من (1.7 eV) إلى (1.4 eV) بزيادة درجة حرارة القاعدة من (C° 275) إلى (C° 325). وفي العام نفسه حضر الباحث اغشية CCTS على قواعد (SLG,FTO) باختلاف تأثير درجة حرارة القاعدة المستخدمة للترسيب بالمدى (400-350-300-250) بطريقة التحلل الكيميائي الحراري وقد بين الباحث أن سمك الاغشية يقل بزيادة درجة الحرارة وإن التحلل يحدث قبل وصول القطرات الى القاعدة الساخنة عند درجة حرارة C° 400 كذلك عرض فحص FE-SEM صورا لأغشية CCTS المحضرة في درجات حرارة مختلفة فقد اظهر أنَ الاغشية المحضرة في درجة حرارة CºO ذات تضاريس غير متناسقة كما ان توافر مراكز التنوي في بعض المناطق ادى الى فرط نمو جسيمات CCTS على سطح الغشاء وهذا يعزى الى التكتل المكون لمجاميع من جسيمات CCTS، أما الاغشية المحضرة عند درجة حرارة C°300 فإنها ذات توزيع غير منتظم للحبوب غير المتساوية مع ملاحظة وجود بعض الفراغات على سطح الغشاء كما تم العثور على تضاريس غير منتشرة على كل مناطق سطح الغشاء. تختلف الاغشية المحضرة عند درجة حرارة C°350 في تضاريسها إذ تبدو اكثر هيمنة وتظهر على سطح هذه الاغشية سلسلة من الرقائق كثافة هذه الرقائق ليست نفسها على كامل السطح ويبدو سطح الغشاء اكثر احكاما مع وجود بعض الفراغات [6].

حضر الباحث (Diwate et al., 2017) اغشية CZTS باستعمال تقنية التحلل الكيميائي الحراري (CSP) بتراكيز مولارية مختلفة من مصدر الكبريت، كانت الاغشية المحضرة متعددة التبلور ذات تركيب (kestrite) الرباعي القائم وبالاتجاه السائد (112)، وإن معدل الحجم البلوري المحسوب بطريقة شرر (Scherrer method) يقل بزيادة تركيز الكبريت كما لاحظ الباحث إن سمك الاغشية يقل من (mm 292–505) بزيادة تركيز الكبريت من (0.12-0.16 M) وعند زيادة تركيز الكبريت الى (0.18 M) يزداد السمك الى (0.18 M) يزداد السمك الى (439 nm) وهذا يشير الى أن عملية نمو اغشية (CZTS) تجري عبر عمليات التنويه والنمو المعقدة المختلفة التي تحدث في وقت واحد على القاعدة، كما اظهرت مطيافية رامان قمة منفردة عند (<sup>1</sup> - 332 وبينت القياسات الكهربائية توصيلية من النوع الموجب P-type تعود لحاملات الشحنة الاغلبية (الفجوات)[32].

 قام الباحثان (Ghediya and Chaudhuri, 2018) بترسيب اغشية CCTS الرقيقة من المحلول الجزيئي باستخدام تقنية (dip-Coating) يتكون المحلول الجزيئي من معقد (الثايوريا +المعادن) المذابة في الميثانول ، إذ يتم تجفيف الاغشية بدرجة حرارة C° 200 لمدة min. و أظهرت نتائج فحوصات حيود الاشعة السينية وتحليل طيف رامان Stannite النقى لأغشية CCTS اذ ظهرت قمم الحيود عند طور (204) و (204) التي تميز الحيود عند المستويات (112) و (204) و (204) و (312) على التوالي لمركب CCTS بالمقارنة مع البطاقة القياسية (ICDD) ذات الرقم التسلسلي (0513–26) وكان الحجم البلوري المحسوب باستخدام معادلة شيرر Scherrer تقريبا (5nm)، وظهرت قمة رامان عند <sup>1-3</sup>32cm فقط كطور منفرد كما وبينت الفحوصات البصرية (UV-visible) ان النفاذية تكون عالية من(UV-visible) وتقل عند 1100nm فما دون، ووجد أن قيمة فجوة الطاقة للأغشية تساوى (eV) ولمحلول الطلاء (1.3 eV). كشفت القياسات الكهربائية عن قيمة التوصيلية الكهربائية تساوى  $.[20] (0.07 \text{ S.cm}^{-1})$ 

■ عمل الباحثان (Sharma and Thangavel, 2018) على تحضير اغشية CCTS
الرقيقة من المحاليل بطريقة (Sol-gel) ثم ترسيبها بتقنية (Spin Coating)، وقد اظهرت
نتائج حيود الاشعة السينية انماط الحيود عند (°28.6~20) التي تقابل المستوي (112) و
التي تؤكد ان المركب ذو تركيب رباعي قائم وبطور (Stannite)، كما وبينت صور
(FE-SEM) ان الاغشية ذات سطح متجانس ومنتظم. عن طريق فحص (UV-Visible)
تم حساب قيمة فجوة الطاقة ووجد انها تساوي (1.45 eV) وهي مناسبة تماما
للاستخدام في تطبيقات الخلايا الشمسية، وأكد قياس تأثير هول ان اغشية CCTS من
النوع الموجب (P-type) و بمقاومية تقريبا (Ω.04Ω.cm~) وتحركية للحاملات
تقريبا (4.665 cm²v⁻¹s⁻¹) وتركيزها (3.11×10 <sup>18</sup> cm <sup>-3</sup> ) [33].

حضر الباحث (Wang et al.2108) أغشية المركب Cu<sub>2</sub>CoSnS<sub>4</sub> بنجاح بطريقة الترذيذ بالتردد الراديوي المغناطيسي (RF) بتأثير اختلاف ترتيب تسلسل الطبقات المترسبة (Cu/Sn/Co,Cu/Co/Sn) و درجة حرارة القاعدة على الخصائص التركيبية والبصرية. بينت نتائج فحص حيود الاشعة السينية (XRD) وتحليل طيف رامان ان الاغشية التي تحضيرها ذات تركيب رياعي بطور Stannite، وان نوعية التبلور وهيكلية التركيب قد تحسنت مع ارتفاع درجة الحرارة، إذ أن أفضل غشاء تم الحصول عليه كان بدرجة حرارة راد أن (2° 000) للترتيب (Cu/Co/Sn) الذي يمتلك فجوة طاقة بقيمة (VRD).

#### (10-1) الهدف من البحث

### (The Aim of The Work)

تهدف الدراسة الحالية الى تحضير اغشية CCTS الرقيقة على قواعد زجاجية وبدرجة حرارة قاعدة (2° 400) بطريقة التحلل الكيمائي الحراري للحصول على اغشية بمواصفات جيدة من تجانس عالي وقوة التصاق بالقاعدة وبسمك تقريبي(nm 350) ، ودراسة تأثير تركيز الكبريت على بعض خصائصها التركيبية والبصرية و الكهربائية، وذلك لغرض الحصول على اغشية ذات مواصفات فيزيائية جيدة يمكن استخدامها في تطبيقات الخلايا الشمسية والكهرو بصرية.